

Interscale Flexible Heat Conductor (FHC), 70 mm

Servicios públicos de energía



Conductor block expands/contracts vertically to compensate for tolerance stack up and optimizes surface contact and pressure along the thermal path; eliminates the need for a thermal gap pad.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Designed for ATX/ITX/Mini ITX & COM using Intel core-ipcprocessors and AMD processors with the following sockets: Intel: LGA775, LGA1150, LGA1155, LGA1156, LGA1366,LGA2011 ; AMD: AM2, AM2(+), AM3, AM3(+), FM1, FM2, FM2(+)

Compatible with Interscale C enclosures

Provides industry leading conduction cooling performance, 70% improvement over current conduction cooling methods

Conductor block expands/contracts vertically to compensate fortolerance stack up and optimizes surface contact and pressurealong the thermal path; eliminates the need for a thermal gappad

Secured to PCB with mounting brackets, sold separately

ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de catálogo	Tipo	Works With	Package Quantity	Profundidad	Ancho
--------------------	------	------------	------------------	-------------	-------

24830-001	Heat Conductor	Cases	1	50 mm	50 mm
-----------	----------------	-------	---	-------	-------

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Please order the mounting bracket (Intel or AMD, listed under accessories) to assemble the FHC to the board.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE